

HCC302 夹盘

温控晶圆夹盘

产品简介

HCC302 温控晶圆夹盘支持 -120°C ~ 310°C范围的样品温控,并且温度均匀性非常优异好。

功能特点

可编程精密控温。可独立控制,也可从上位机软件控制
超低的盘面温度梯度

软件可拓展性强,可提供 LabView 等语言的 SDK

#升级项# 性能可升级,详见 配置列表

#选择项# 是否带有上盖。上盖功能如下:

可变样品腔高度

可拆卸的观察窗

用于负温时的除霜设计

向腔室内充入气氛

可做改动或定制,详询上海恒商

技术参数

温控性能	温度范围	-120°C ~ 310°C 负温需使用液氮制冷 可提升温度上限
	温度分辨率	0.001°C
	温度稳定性	±0.05°C(at 100°C) 可提升稳定性
	温度均匀度	±0.1°C/cm 可升级均匀性
	最小控温速度	±0.1°C/小时
	最大加热速度	+50°C/分钟(at 100°C)
	最大制冷速度	-50°C/分钟(at 100°C)
	温度传感器	100Ω铂质 RTD
温控方式	开关式 PID 可升级为 LVDC 式 PID	
尺寸	样品腔面积	48 mm x 60 mm
	样品观察范围	26.5 mm(使用外盖)

*注:液氮泵型号不同,制冷表现也会有差异,请悉知



配置列表

标准	HCC302 温控晶圆夹盘	√
	mK2000 温度控制器 软件免费,控制线有多种接口供选	√
升级	最高温度 从 600°C 升级为 更高	
选配件	上盖	
	液氮制冷系统 包含液氮泵与液氮罐,使样品降至负温	
	外壳水冷配件 用常温水或冰水循环防止外壳过热	
	固定支架 把夹盘固定在使用平台上,防止滑动	
	温控联动显微镜相机 温度-图像联动工作,附软件	
	线性可变直流电源(LVDC) 装在温控器里,抑制电噪音	

*注:产品有多种配置变化,详询上海恒商